



# 漢科系統科技股份有限公司

## 法 人 說 明 會 Wholetech System Hitech Limited Investor Conference

公司網址：<https://www.wholetech.com.tw>

發言人 / 投資人連絡窗口

姓名：蕭燕啁

傳真：03-5210028

電話：03-5228823 分機1615

Email: [novia.hsiao@wholetech.com.tw](mailto:novia.hsiao@wholetech.com.tw)

# 漢科系統科技股份有限公司 法 人 說 明 會

Wholetech System Hitech Limited Investor Conference

## 報 告 人

主 講 人：林志煌 / 副總經理

會計主管/發言人：蕭燕啣 / 財務副總

114 / 11 / 27

## 免 責 聲 明

### Disclaimer

The above statements that pertain to future projections constitute the expectations, opinions, outlooks, or predictions of our company and its affiliates based on information available at the time the statements were made. Such statements may be affected by known and unknown risks and inherent uncertainties, the existence of emergence of facts or factors that differ from the assumptions, suppositions, or judgments of the Company, or other factors, Consequently, there may be significant discrepancies between actual results pertaining to the Company's future earnings, management results, financial conditions, and other matters as explicitly or implicitly referred to in the statements and the content of such statements.

The presentation is run exclusively for the purpose of providing information and not for the purpose of soliciting investments or recommending the buying or selling of specific shares or products. Company makes no warranty concerning the accuracy or completeness of the information and will not be liable for any damages arising out of use of the information thereof.

本報告內容係依現有資訊而做成，上述說明中的財務或相關資訊可能包含一些對本公司及其子公司未來前景的說明，這些說明易受重大的風險和不確定因素影響，致使最後結果與原先的說明迥異，是本公司特此聲明，本報告中的內容，僅為資訊流通之目的而公佈，並非投資建議，本公司不對報告內容的正確性、完整性或任何使用本報告內容所產生的損害負任何責任。

## 目 錄 AGENDA

1. 公司簡介 (About WHOLETECH)
2. 營運概況說明 (Operation)
3. 財務狀況說明 (Financials)
4. 業務展望 (Future Prospects)
5. Q&A

# 公 司 簡 介

## About WHOLETECH

## 公司簡介



股票代號：3402



### 公司創立



創立日期:1990/07



上櫃日期:2007/01



集團員工人數:665



實收資本額:7億3仟47萬元



### 領航

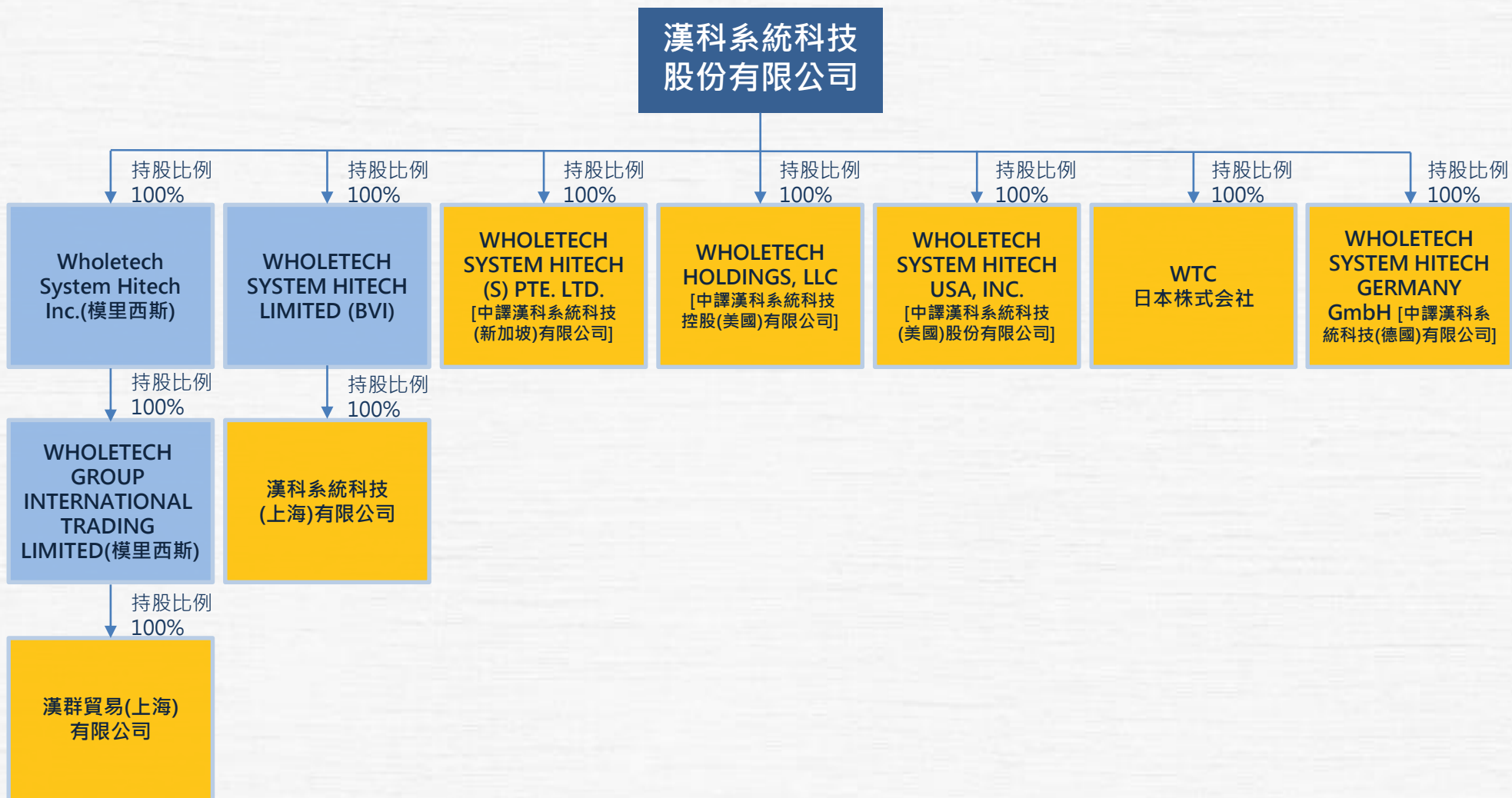


董事長 温永宏

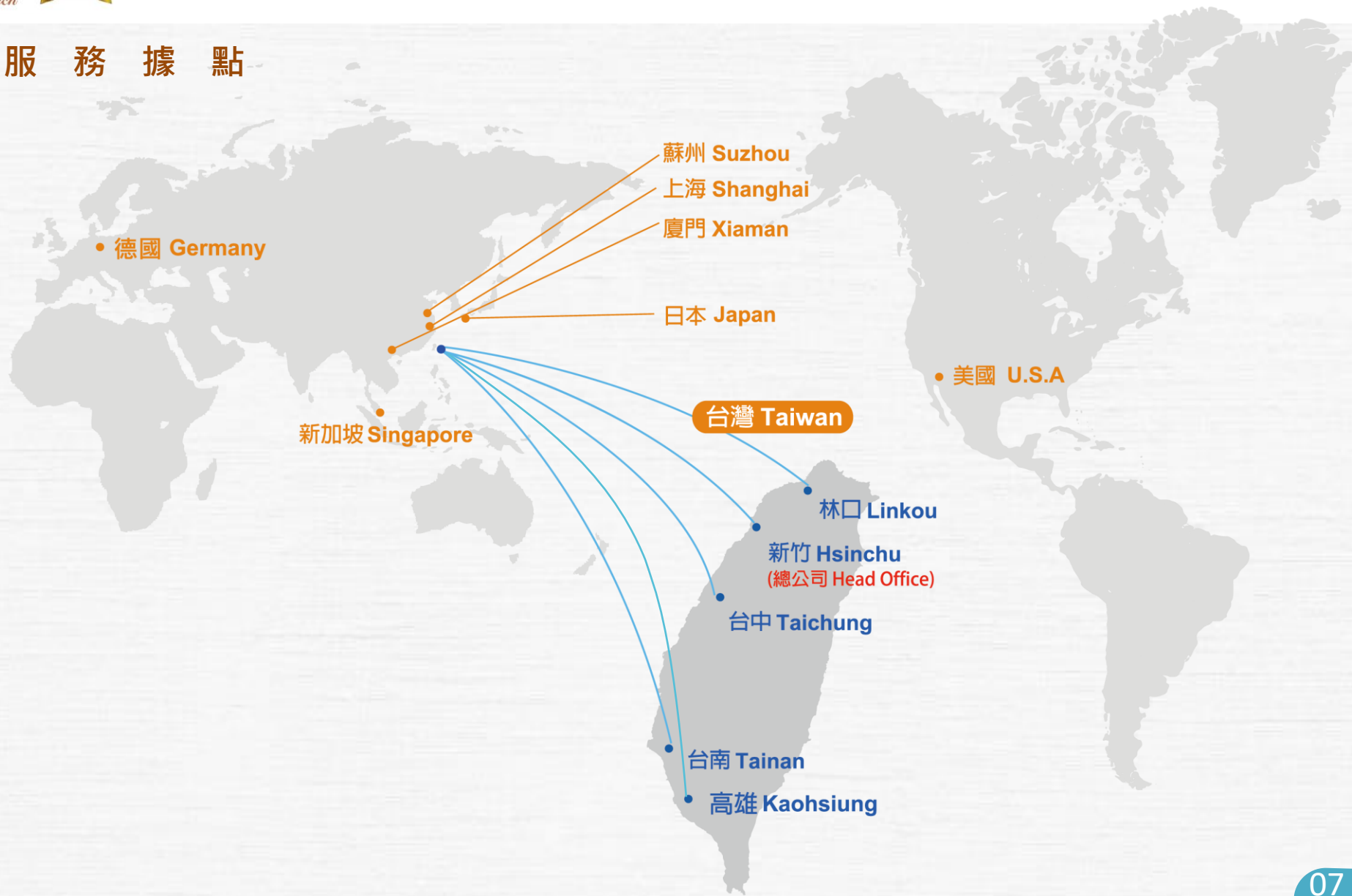


總經理 謝清泉

## 關係企業組織圖



## 服務據點



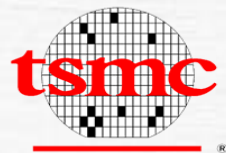
## 主要業務範圍

漢科團隊的專業技術能力和豐富的工程實務經驗，成立了全方位的系統整合服務平台，現有七大專業事業部門：



- W1** 氣體 / 特殊管路工程事業部
- W2** 無塵室 & 機電統包事業部
- W3** 高真空系統事業部
- W4** 特氣供應 & 監控系統整合事業部
- W5** 先進產品事業部
- W6** 系統軟體研發部
- W7** 濕製程設備 & 化學系統

# 主要客戶群



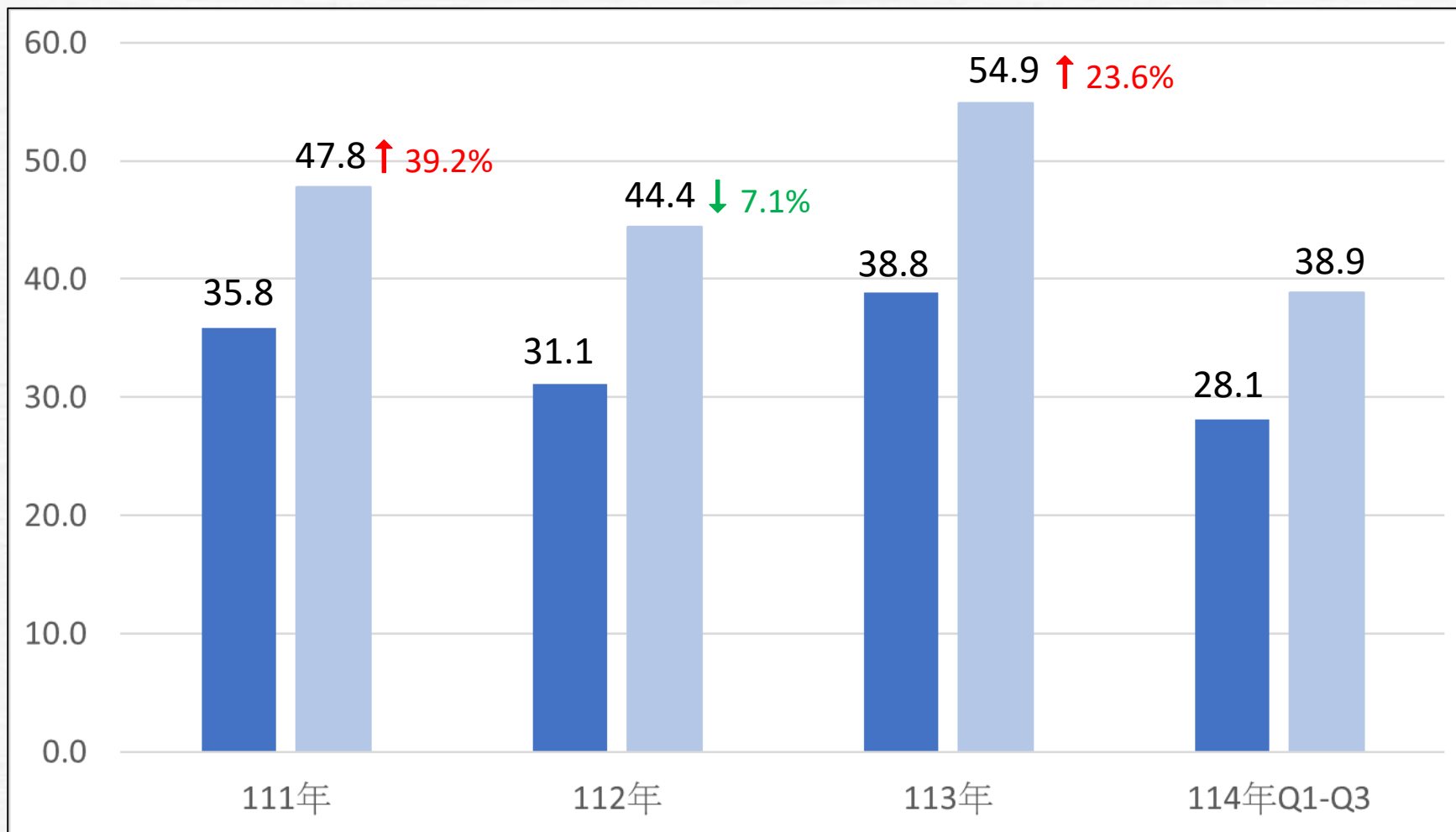
# 營 運 概 況 說 明

## ( O p e r a t i o n )

■ 個體營收  
■ 合併營收

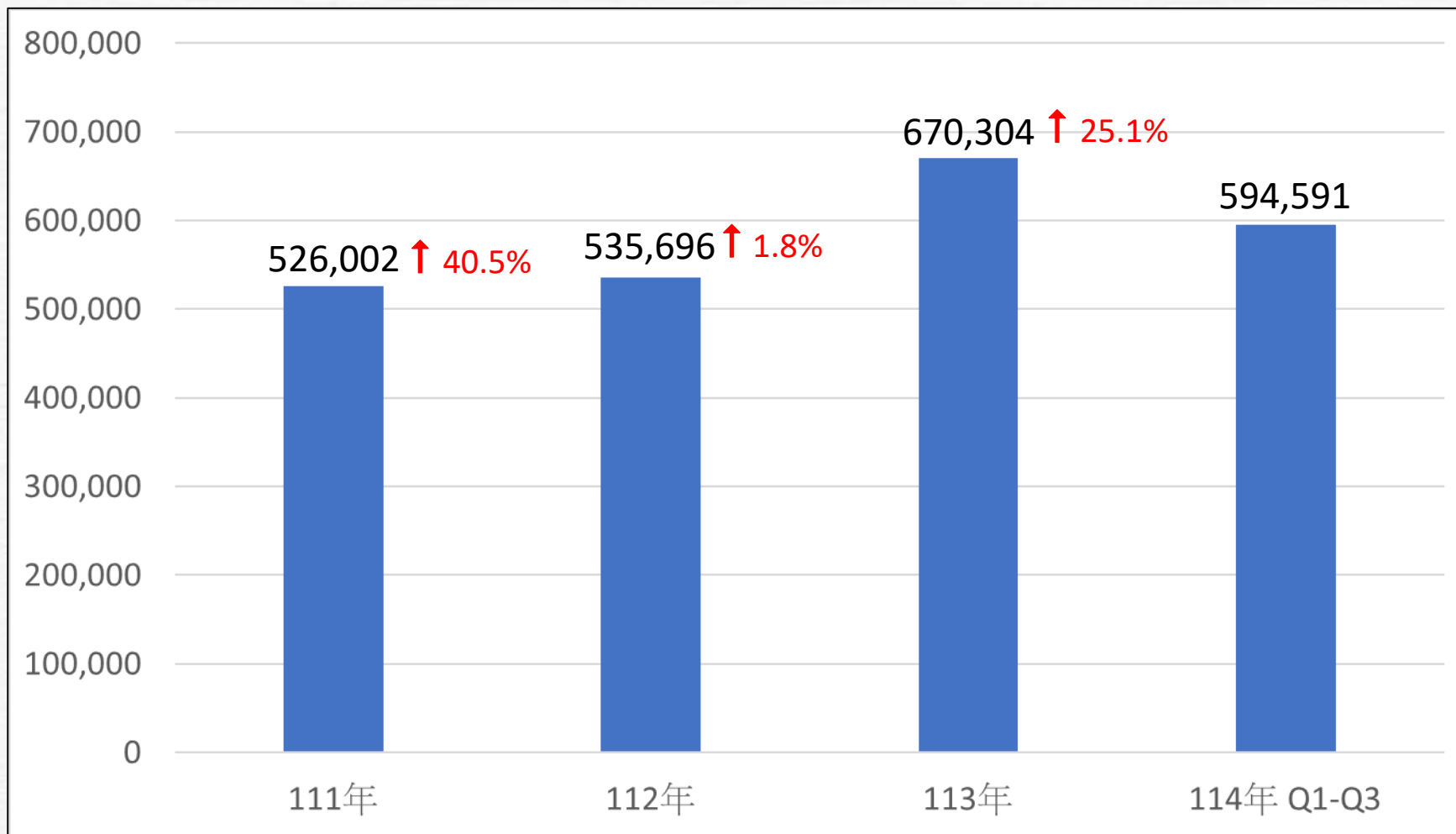
## 近三年營收 (Revenue)

單位：億元  
Unit : NTD 100 million



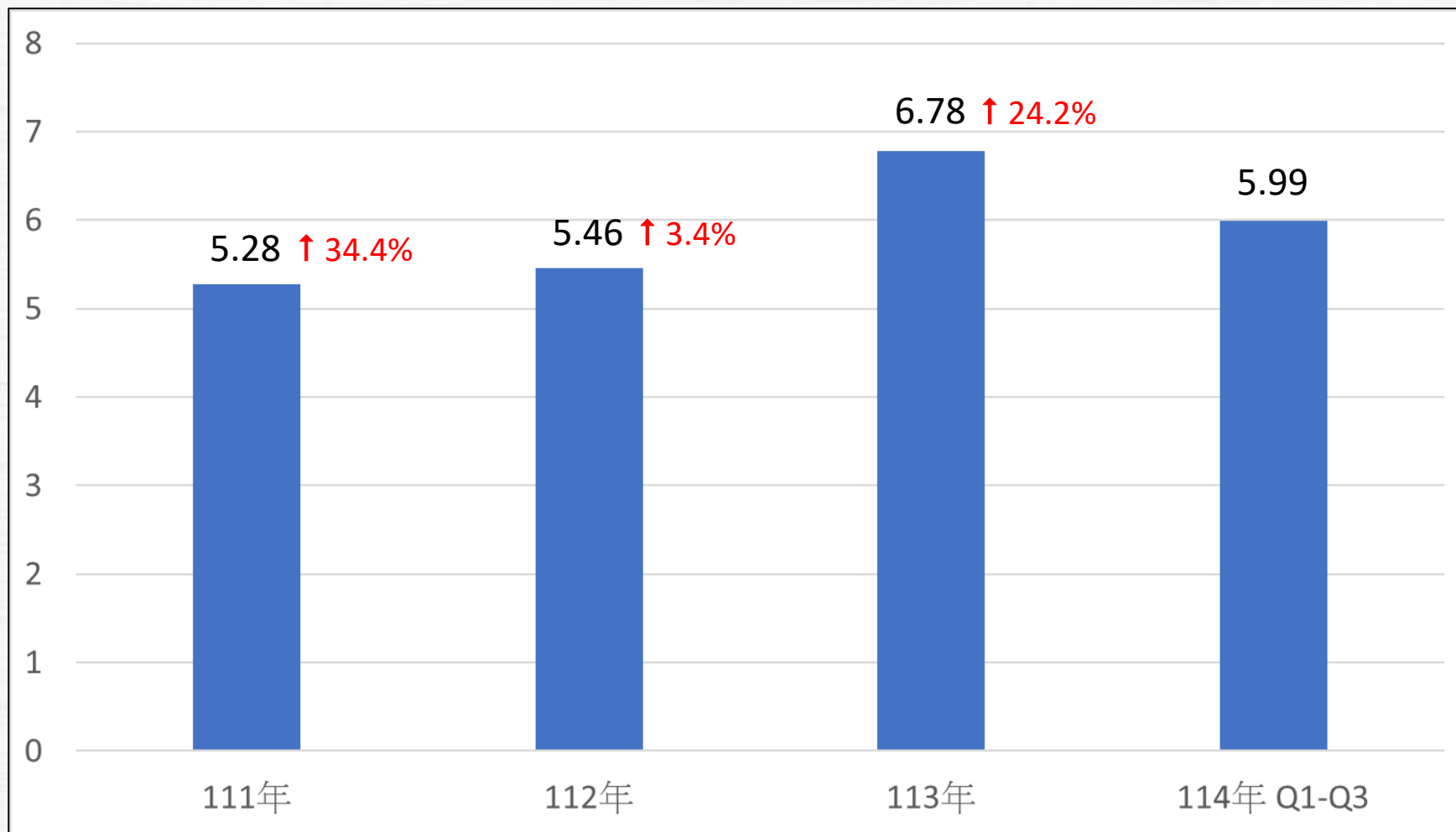
## 近三年稅前淨利 (EBIT)

單位：仟元  
Unit : NTD thousand



## 近三年每股盈餘 (EPS)

Unit : NTD



## 近三年盈餘分配狀況 Income Statement

	111年 (2022)	112年 (2023)	113年 (2024)	114年1月1日至9月30日 2025 Jan.~Sep.
營業收入(仟元) Rev.(thousand)	4,777,624	4,438,601	5,487,092	3,886,105
毛利(仟元) Gross Profit(thousand)	831,273	927,851	1,161,573	980,700
毛利率Gross Profit%	17.40%	20.90%	21.17%	25.24%
本期稅前損益(仟元) EBIT(thousand)	526,002	535,696	670,304	594,591
本期稅後損益(仟元) EAT(thousand)	385,707	399,033	495,124	437,373
基本每股盈餘(元) EPS	5.28	5.46	6.78	5.99
現金股利(元) Cash Dividends	4.20	4.50	5.00	
股利發放率 Dividend Payout Ratio	79.55%	82.42%	73.75%	
負債占資產比率 Debt Asset Ratio	71.10%	69.58%	68.36%	
流動比率 Current Ration	129.00%	130.77%	129.34%	
純益率 Net Profit Margin	8.07%	8.99%	9.02%	

# 財 務 狀 況 說 明

## ( F i n a n c i a l s )

# 114 Q3合併資產負債表

## 2025 Q3 Consolidated Balance Sheet

 單位：仟元  
 Unit：NTD thousand

	114年9月30日	113年12月31日	113年9月30日	112年9月30日		114年9月30日	113年12月31日	113年9月30日	112年9月30日
現金及約當現金 Cash	3,052,219	3,242,199	2,388,330	1,745,785	應付帳款 PA	2,165,981	1,452,469	1,422,298	1,476,783
合約資產 - 流動 Contract assets-current	922,579	874,673	812,072	832,294	合約負債 - 流動 Contract liabilities	1,697,889	2,247,716	2,073,725	1,599,553
其他流動資產 Others	1,781,206	1,408,586	2,004,660	2,160,321	其他流動負債 Others	757,041	572,015	560,501	481,070
流動資產合計 Total Current Assets	5,756,004	5,525,458	5,205,062	4,738,400	流動負債合計 Total Current Liabilities	4,620,911	4,272,200	4,056,524	3,557,406
不動產、廠房及設備 PPE	1,126,156	926,079	911,566	682,896	其它非流動負債 Others	196,537	186,968	191,984	169,660
其他非流動資產 Others	46,750	71,815	71,723	73,543					
非流動資產合計 Total Non-current Assets	1,172,906	997,894	983,289	756,439	負債總計 Total Liabilities	4,817,448	4,459,168	4,248,508	3,727,066
					股東權益總計 Total SE	2,111,462	2,064,184	1,939,843	1,767,773
資產總計 Total Assets	6,928,910	6,523,352	6,188,351	5,494,839	負債及權益總計 Total Liabilities+SE	6,928,910	6,523,352	6,188,351	5,494,839

淨值	28.91元	28.26元	26.56元	24.20元
----	--------	--------	--------	--------

# 114 Q3及113年合併損益表

## 2025 Q3&2024 Consolidated Income Statement

 單位：仟元  
 Unit：NTD thousand

	114年7月1日 至9月30日		113年7月1日 至9月30日		112年7月1日 至9月30日		114年1月1日 至9月30日		113年1月1日 至9月30日		112年1月1日 至9月30日	
工程收入 Revenue	1,362,392	100%	1,403,727	100%	1,082,376	100%	3,886,105	100%	4,127,771	100%	3,077,040	100%
工程成本 Cost	1,028,593	76%	1,090,553	78%	845,203	78%	2,905,405	75%	3,304,780	80%	2,420,799	79%
營業毛利 Gross Profit	333,799	24%	313,174	22%	237,173	22%	980,700	25%	822,991	20%	656,241	21%
營業費用 Operating expenses	142,184	10%	159,899	11%	115,457	11%	415,745	11%	405,663	10%	354,788	11%
營業淨利 Operating Income	191,615	14%	153,275	11%	121,716	11%	564,955	14%	417,328	10%	301,453	10%
營業外收入及支出淨額 Net non-operating income and expenditure	6,423	1%	16,866	1%	26,294	2%	29,636	1%	78,407	2%	87,327	3%
稅前淨利 EBIT	198,038	15%	170,141	12%	148,010	13%	594,591	15%	495,735	12%	388,780	13%
所得稅費用 Income Tax	50,084	4%	41,352	3%	34,606	3%	157,218	4%	134,071	3%	103,794	4%
本期淨利 Net Income	147,954	11%	128,789	9%	113,404	10%	437,373	11%	361,664	9%	284,986	9%
本期淨利歸屬於母公司 Net Income(Parent company)	147,954	11%	128,789	9%	113,404	10%	437,373	11%	361,664	9%	284,986	9%
綜合損益歸屬於母公司 Composite Net Income (Parent Company)	187,093	14%	148,777	11%	133,162	12%	412,517	11%	400,355	10%	290,761	9%
基本每股盈餘 EPS	2.03		1.76		1.55		5.99		4.95		3.90	
稀釋每股盈餘 Diluted EPS	2.02		1.75		1.54		5.95		4.92		3.85	

## 業 務 展 望

(Future Prospects)

## 漢科經營策略

### 專業

深耕高潔淨氣體管路利基市場追求卓越

### 統包

發展全方位的技術能力，擴大經濟規模，強化競爭優勢

### 多角化經營

以工程服務三十多年的經驗，支持設備製造的快速成長，建立設備品牌形象，拉大與跟隨者的差距，成為一線廠商的佼佼者

### 提升競爭力

注重安全與品質，並且與客戶建立長期良好的伙伴關係，嚴格控制成本，授權幹部自主管理，發揮團隊精神

## 漢科優勢

01 豐富的工程實績

02 內控及財務管理健全

03 自有設計及施工團隊

04 優良品質及安全形象與信譽

05 標準化及客製化設備品牌

06 創新服務模式

## 漢科自製設備介紹

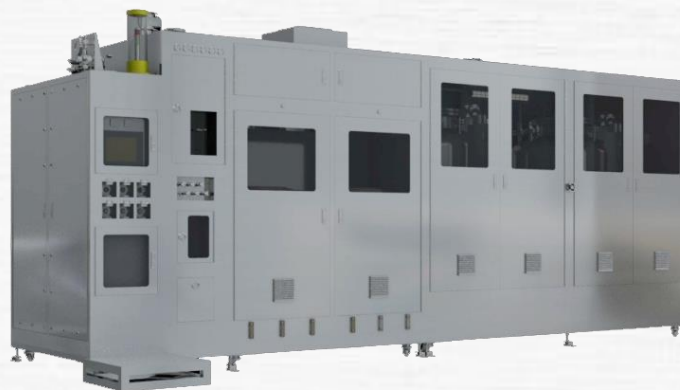
特殊氣體供應設備  
Specialty Gas  
Supply Unit



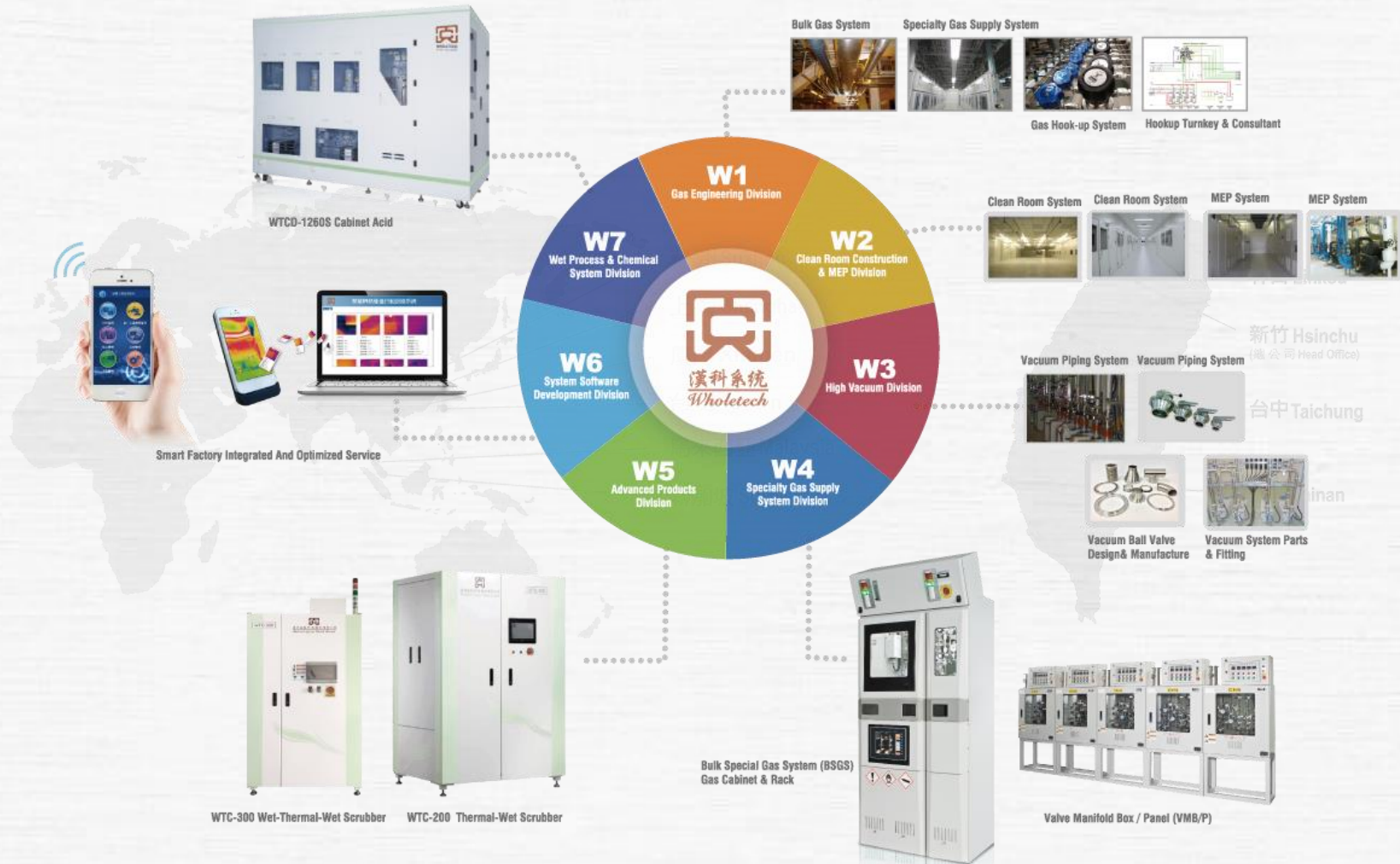
製程尾氣處理設備  
Local Scrubber



化學品供應設備  
Chemical Supply Unit



# 漢科全方位系統整合-推動高科技產業全面升級



## 2026年半導體產業展望

資策會產業情報研究所(MIC)於9/8-9/9舉辦第38屆MIC FORUM Fall  
《馭變：科技主權 全球新局》研討會

### 1. 半導體市場成長動能：

- 2026-2028年全球半導體市場持續高度成長。
- AI應用與終端產品換機需求為兩大成長動能。

### 2. AI應用與周邊成長：

- 強勁驅動高效能運算 ( HPC ) 晶片市場。
- 先進封裝技術的擴展。

### 3. 2026年全球

- AI PC滲透率達54.7%，AI手機滲透率達38%。
- AI PC平價化將驅動市場成長。

### 4. 量子AI推動邏輯晶片與封裝技術發展。



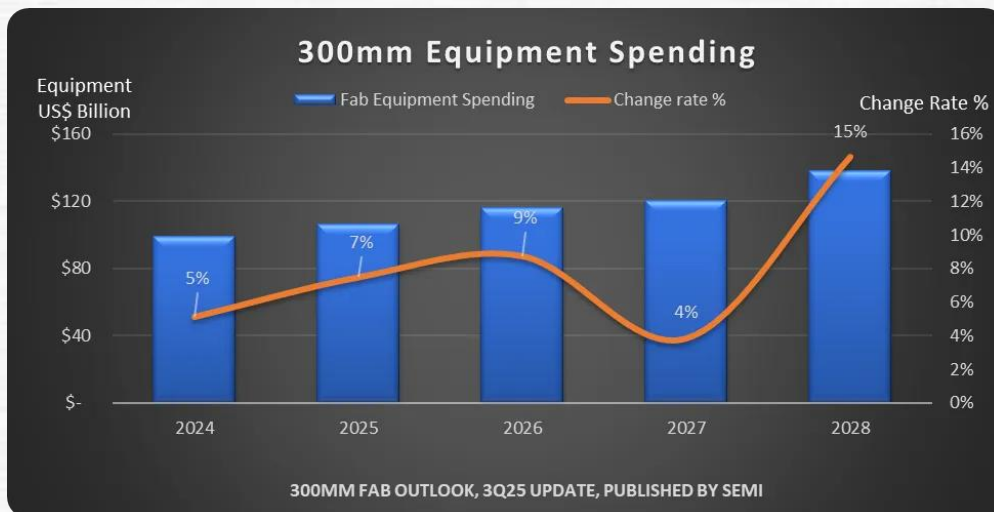
資料來源: 資策會MIC、自由財經

## 2026年半導體產業展望

2025/10/08

國際半導體協會(SEMI)發布報告指出

- 1.2025年，12吋晶圓廠設備支出將增至1070億美元，年增7%。2026年預估支出達1160億美元，年增9%。2027年達1200億美元，年增4%；2028年再增15%至1380億美元。
- 2.台灣預計未來3年支出750億美元，位居全球第3，著重於2奈米以下製程的先進邏輯技術。
- 3.SEMI並預估，未來3年中國將支出約940億美元，韓國將支出860億美元，美洲將支出約600億美元，日本將支出約320億美元，歐洲和中東支出約140億美元，東南亞支出約120億美元。



資料來源:SEMI Reports

## 業務展望

全球半導體產業穩健成長，驅動科技創新不斷邁進，漢科以堅實的核心技術為基礎，結合卓越的系統整合能力、靈活的服務機制與完善的供應鏈管理，持續強化關鍵競爭力，掌握市場脈動，創造穩定的訂單與營收成長。

展望2026年，全球半導體市場將聚焦於AI、HPC(高效能運算)、IoT(物聯網)與車用晶片等關鍵領域，隨著晶片設計日益複雜，2.5D/3D先進封裝技術蓬勃發展，推升臺灣於全球先進封裝版圖中穩居領先地位。

面對產業區域化的全球趨勢，漢科深知供應鏈穩定與即時服務的重要性，已佈局新加坡、美國、德國、日本與中國等國際據點，與全球晶圓、封測及設備夥伴緊密合作。我們以專業實力為後盾，以信任與共榮為核心，持續為客戶提供穩定、高效、具前瞻性的服務，共創永續雙贏的未來。



[www.wholetech.com.tw](http://www.wholetech.com.tw)

## 漢科系統科技股份有限公司

